

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：鍾嘉芸
電話：03-5912685
E-mail：eldachung@itri.org.tw



1100019655024

300091 新竹市科學園區新安路 2 號

受文者：科技部新竹科學工業園區管理局

發文日期：中華民國 110 年 09 月 24 日

發文字號：工研轉字第 1100019655 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：工研院擬舉辦「雷射應用及資通訊光電等研發成果讓與案」之公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，工研院將舉辦雷射應用及資通訊光電等研發成果讓與案(專利 64 案 155 件)之公開招標活動(讓與標的詳如附件)。

二、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

(一) 本案截標日為民國(下同)110 年 10 月 7 日，開標日為 110 年 10 月 8 日。

(二) 詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考下列網址：
工研院研發成果公告網站

(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1127353332214152760)

(三) 公開說明會資訊：

1. 舉辦時間：110 年 10 月 1 日 10 時至 11 時。

總收文



1100027944

2. 舉辦地點：以線上會議方式舉辦。

3. 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 110 年 9 月 30 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「雷射應用及資通訊光電等研發成果讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 110 年 9 月 30 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

三、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 鍾小姐

電話：(03) 591-2685

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：eldachung@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：科技部新竹科學工業園區管理局

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行



110 年度工研院 雷射應用及資通訊光電等專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質研發成果可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質研發成果，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人（以下簡稱「國內廠商」）。

三、讓與標的：本讓與案包含通訊、面板、網路、雲端、人工智慧、雷射創新應用、軟性製造技術、智慧光纖雷射源、積層製造技術等研發成果 64 案 155 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」共分為九個類別：（一）通訊（7 案 22 件）、（二）面板（10 案 28 件）、（三）網路（4 案 14 件）、（四）雲端（1 案 4 件）、（五）人工智慧（5 案 16 件）、（六）雷射創新應用（17 案 27 件）、（七）軟性製造技術（11 案 21 件）、（八）智慧光纖雷射源（5 案 8 件）、（九）積層製造技術（4 案 15 件）。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）110 年 10 月 1 日 10 時整以線上會議方式舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 110 年 9 月 30 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「雷射應用及資通訊光電等專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱、手機號碼及電子郵件信箱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 110 年 9 月 30 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 110 年 10 月 7 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填



寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、公司基本資料暨運用規劃說明表及商業營運計畫書一式 7 份（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「雷射應用及資通訊光電等專利讓與案投標」，於截標日 110 年 10 月 7 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達至：
310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室工研院技轉法律中心 鍾小姐收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案研發成果不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、本讓與案採最有利標，投標廠商應檢附商業營運計畫書，其內容應包含以下事項：

1. 公司簡介（10%）
2. 公司研發能力（40%）：應包含公司智權能量。
3. 公司營運規劃（40%）：應包含受讓專利後如何結合公司發展策略進行後續運用。
4. 其他（10%）：例如對國內社會及產業貢獻程度（如投資額、就業人數、繳稅額、對國內產業鏈/生態系之角色）、以及與工研院合作規劃等等。

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，



若於決標前未能補足者，其投標為無效。

7. 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及/或工研院同意者，不在此限。
8. 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

九、決標方法：

1. 開標日為 110 年 10 月 8 日。（開標時間及地點請於開標日前一日洽詢「技轉法律中心」聯絡人）。
2. 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
3. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表、商業營運計畫書進行形式審查。
4. 投標廠商通過形式審查者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書進行審查評比，投標廠商應自行或委託代理人蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔及書面文件。蒞會之出席人員應出具授權證明文件。
5. 工研院開標審議委員會會議將以商業營運計畫書總評比分數高低順序進行開標，以投標金額高於底價者得標。有二家（含）以上投標廠商總評比分數相同且投標金額均高於底價時，以總價高者得標；有二（含）以上投標廠商總評比分數相同、投標金額均高於底價，且總價相同者，由工研院現場抽籤決之。
6. 開標時將請律師到場監標。
7. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
8. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
9. 就「讓與標的」曾與工研院簽定有優先承買權之廠商，得主張優先承買該「讓與標的」，其條件悉依雙方契約約定辦理。若另有其他優先承買權人就同一「讓與標的」同時主張行使優先承買權時，工研院將依公平公正評選，以最有利臺灣產業之標準決定讓與條件及對象。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 20 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。



3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」自雙方依法簽章並經經濟部同意後生效。得標廠商充分了解工研院對於經濟部之意見並無影響力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」生效前：（1）工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；（2）工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及（3）工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，應依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，取得主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）核准及/或工研院同意後始得為之，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任



何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院研發成果讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，為一切必要之申請，且得標廠商應於取得主管機關核准及/或工研院同意後，始得為下述行為：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。得標廠商為前述申請時，應將其檢視該研發成果運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，並應配合工研院向主管機關為一切必要之申請及提供一切相關之文件。
13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：
 - (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
 - (2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
 - (3) 為增進國家重大利益者。得標廠商並同意，若違反「十、契約事項:」之第 4、8、9、12、14、15 及 16 項等約定者，或有第 13 項情事者，工研院得逕行將「讓與標的」過去、現在及未來之權利，非專屬授權予第三人，並保有相關之



收益且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及工研院亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
15. 得標廠商應使所有「後手」遵守「十、契約事項:」之第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 17 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院，並取得工研院書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
17. 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（下稱：股權變動）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於股權變動情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該股權變動情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告「讓與標的」投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 鍾小姐



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

電話：+886 591-2685，傳真：+886 582-0466

電子信箱：eldachung@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：研發成果清單

(一) 通訊 (7 案 22 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	中文名稱	申請案號	官方申請日	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P52070084TW	發明	審查中	中華民國	無主動電源的電子鎖、具有電子鎖的電子裝置及操作電子鎖的方法	TW108132087	20190905	經濟部技術處	工研院	
	2	P52070084US	發明	審查中	美國	無主動電源的電子鎖、具有電子鎖的電子裝置及操作電子鎖的方法	US16561030	20190905	經濟部技術處	工研院	
2	3	P52080005CN	發明	審查中	中國大陸	由 IAB 節點使用的 RLC SDU 傳輸方法以及使用該方法的 IAB 節點	CN202010069339.2	20200121	經濟部技術處	工研院	
	4	P52080005TW	發明	獲證	中華民國	由 IAB 節點使用的 RLC SDU 傳輸方法以及使用該方法的 IAB 節點	TW109102095	20200121	經濟部技術處	工研院	
	5	P52080005US	發明	審查中	美國	由 IAB 節點使用的 RLC SDU 傳輸方法以及使用該方法的 IAB 節點	US16726135	20191223	經濟部技術處	工研院	
3	6	P52080015CN	發明	審查中	中國大陸	使用混合波束成形並執行天線校準方法的收發器	CN201911201923.2	20191129	經濟部技術處	工研院	
	7	P52080015TW	發明	審查中	中華民國	使用混合波束成形並執行天線校準方法的收發器	TW108141316	20191114	經濟部技術處	工研院	
	8	P52080015US	發明	獲證	美國	使用混合波束成形並執行天線校準方法的收發器	US16600579	20191014	經濟部技術處	工研院	
4	9	P52080017CN	發明	審查中	中國大陸	用於上行鏈路數據傳輸的方法及使用其的用戶設備和基站	CN202010361223.6	20200430	經濟部技術處	工研院	
	10	P52080017TW	發明	審查中	中華民國	用於上行鏈路資料傳輸的方法及使用其的用戶設備和基站	TW109114462	20200430	經濟部技術處	工研院	
	11	P52080017US	發明	審查中	美國	用於上行鏈路資料傳輸的方法及使用其的用戶設備和基站	US16862574	20200430	經濟部技術處	工研院	
5	12	P52070019CN	發明	審查中	中國大陸	免調度上行傳輸的用戶設備與其方法	CN201910423957.X	20190521	經濟部技術處	工研院	
	13	P52070019TW	發明	審查中	中華民國	免調度上行傳輸之用戶設備與其方法	TW108117414	20190521	經濟部技術處	工研院	
	14	P52070019US	發明	獲證	美國	免調度上行傳輸之用戶設備與其方法	US16418288	20190521	經濟部技術處	工研院	
6	15	P52080042CN	發明	審查中	中國大陸	未授權頻譜的資源切換的方法和用戶設備	CN202010816971.9	20200814	經濟部技術處	工研院	
	16	P52080042EP	發明	審查中	歐盟	未授權頻譜的資源切換的方法和用戶設備	EP20190617.9	20200812	經濟部技術處	工研院	



7	17	P52080042TW	發明	審查中	中華民國	未授權頻譜的資源 切換的方法和用戶 設備	TW109127650	20200814	經濟部 技術處	工研院	
	18	P52080042US	發明	審查中	美國	未授權頻譜的資源 切換的方法和用戶 設備	US16934554	20200721	經濟部 技術處	工研院	
	19	P52080045CN	發明	審查中	中國大陸	用於帶寬部分操作 的方法及使用其的 用戶設備	CN202010817913.8	20200814	經濟部 技術處	工研院	
	20	P52080045EP	發明	審查中	歐盟	用於頻寬部分操作 的方法及使用其的 用戶設備	EP20190644.3	20200812	經濟部 技術處	工研院	
	21	P52080045TW	發明	審查中	中華民國	用於頻寬部分操作 的方法及使用其的 用戶設備	TW109127684	20200814	經濟部 技術處	工研院	
	22	P52080045US	發明	審查中	美國	用於頻寬部分操作 的方法及使用其的 用戶設備	US16990950	20200811	經濟部 技術處	工研院	

(二) 面板 (10 案 28 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	中文名稱	申請案號	官方申請 日	委辦單位	專利權 人	契約 運用
8	23	P51080031CN	發明	審查中	中國大陸	三維成像系統及方法	CN202010626761.3	20200701	經濟部 技術處	工研院	
	24	P51080031TW	發明	暫准	中華民國	三維成像系統及方法	TW109121476	20200624	經濟部 技術處	工研院	
	25	P51080031US	發明	審查中	美國	三維成像系統及方法	US16917919	20200701	經濟部 技術處	工研院	
9	26	P51080078CN	發明	審查中	中國大陸	半導體封裝結構	CN202010704682.X	20200721	經濟部 技術處	工研院	
	27	P51080078TW	發明	暫准	中華民國	半導體封裝結構	TW109122597	20200703	經濟部 技術處	工研院	
	28	P51080078US	發明	審查中	美國	半導體封裝結構	US17216686	20210330	經濟部 技術處	工研院	
10	29	P51090011CN	發明	審查中	中國大陸	重布線結構及其形成方法	CN202010986266.3	20200918	經濟部 技術處	工研院	
	30	P51090011TW	發明	審查中	中華民國	重布線結構及其形成方法	TW109132250	20200918	經濟部 技術處	工研院	
	31	P51090011US	發明	審查中	美國	重布線結構及其形成方法	US17144144	20210108	經濟部 技術處	工研院	
11	32	P51090013CN	發明	審查中	中國大陸	受壓狀態量測方法及受壓狀態 量測系統	CN202010770902.9	20200804	經濟部 技術處	工研院	
	33	P51090013TW	發明	審查中	中華民國	受壓狀態量測方法及受壓狀態 量測系統	TW109121587	20200624	經濟部 技術處	工研院	非專 授權 中
	34	P51090013US	發明	審查中	美國	受壓狀態量測方法及受壓狀態 量測系統	US17033694	20200926	經濟部 技術處	工研院	



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

12	35	P51090020CN	發明	審查中	中國大陸	用於信號干擾補償的電子裝置和方法	CN202011258984.5	20201112	經濟部技術處	工研院	
	36	P51090020TW	發明	審查中	中華民國	用於訊號干擾補償的電子裝置和方法	TW109133221	20200925	經濟部技術處	工研院	
	37	P51090020US	發明	審查中	美國	用於訊號干擾補償的電子裝置和方法	US17144151	20210108	經濟部技術處	工研院	
13	38	P51070069USD1	發明	審查中	美國	影像感測器及其製造方法	US17159147	20210127	經濟部技術處	工研院	
14	39	P51090050CN	發明	審查中	中國大陸	生理訊號識別裝置及生理訊號識別方法	CN202110327388.6	20210326	經濟部技術處	工研院	
	40	P51090050TW	發明	審查中	中華民國	生理訊號識別裝置及生理訊號識別方法	TW110106860	20210226	經濟部技術處	工研院	
	41	P51090050US	發明	審查中	美國	生理訊號識別裝置及生理訊號識別方法	US17223012	20210406	經濟部技術處	工研院	
15	42	P51090001CN	發明	審查中	中國大陸	指紋辨識方法及電子互動裝置	CN202010690449.0	20200717	經濟部技術處	工研院	
	43	P51090001TW	發明	審查中	中華民國	指紋辨識方法及電子互動裝置	TW109116491	20200519	經濟部技術處	工研院	
	44	P51090001US	發明	審查中	美國	指紋辨識方法及電子互動裝置	US17143170	20210107	經濟部技術處	工研院	
16	45	P51090006CN	發明	審查中	中國大陸	電子裝置	CN202011002362.6	20200922	經濟部技術處	工研院	
	46	P51090006TW	發明	審查中	中華民國	電子裝置	TW109128727	20200824	經濟部技術處	工研院	
	47	P51090006US	發明	審查中	美國	電子裝置	US17037737	20200930	經濟部技術處	工研院	
17	48	P51080028CN	發明	審查中	中國大陸	熱影像感測系統及熱影像感測方法	CN202010041604.6	20200115	經濟部技術處	工研院	
	49	P51080028TW	發明	獲證	中華民國	熱影像感測系統及熱影像感測方法	TW108136115	20191004	經濟部技術處	工研院	
	50	P51080028US	發明	審查中	美國	熱影像感測系統及熱影像感測方法	US16748724	20200121	經濟部技術處	工研院	

(三) 網路 (4 案 14 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	中文名稱	申請案號	官方申請日	委辦單位	專利權人	契約運用
18	51	P52070058CN	發明	審查中	中國大陸	網路接入方法和 使用網路接入方法的 用戶設備	CN201910677206.0	20190725	經濟部 技術處	工研院	
	52	P52070058TW	發明	暫准	中華民國	網路存取方法和 使用網路存取方法的 用戶裝置	TW108126360	20190725	經濟部 技術處	工研院	
	53	P52070058US	發明	審查中	美國	網路存取方法和 使用網路存取方法的 用戶裝置	US16521597	20190725	經濟部 技術處	工研院	



19	54	P52070127CN	發明	審查中	中國大陸	集中管理節點、分布式節點以及包延遲控制方法	CN201911241346.X	20191206	經濟部技術處	工研院
	55	P52070127TW	發明	審查中	中華民國	集中管理節點、分散式節點以及封包延遲控制方法	TW108144268	20191204	經濟部技術處	工研院
	56	P52070127US	發明	審查中	美國	集中管理節點、分散式節點以及封包延遲控制方法	US16703860	20191205	經濟部技術處	工研院
20	57	P52080019EP	發明	審查中	歐盟	應用於視訊內容編碼之多重參考鄰邊之畫面內預測之自適應性濾波方法、使用上述方法的視訊編碼裝置及視訊解碼裝置	EP19183138.7	20190628	經濟部技術處	工研院
	58	P52080019JP	發明	暫准	日本	應用於視訊內容編碼之多重參考鄰邊之畫面內預測之自適應性濾波方法、使用上述方法的視訊編碼裝置及視訊解碼裝置	JP2019121664	20190628	經濟部技術處	工研院
	59	P52080019TW	發明	獲證	中華民國	應用於視訊內容編碼之多重參考鄰邊之畫面內預測之自適應性濾波方法、使用上述方法的視訊編碼裝置及視訊解碼裝置	TW108122730	20190628	經濟部技術處	工研院
	60	P52080019US	發明	獲證	美國	應用於視訊內容編碼之多重參考鄰邊之畫面內預測之自適應性濾波方法、使用上述方法的視訊編碼裝置及視訊解碼裝置	US16455765	20190628	經濟部技術處	工研院
	61	P52080019CN	發明	審查中	中國大陸	應用於視訊內容編碼之多重參考鄰邊之畫面內預測之自適應性濾波方法、使用上述方法的視訊編碼裝置及視訊解碼裝置	CN201910572940.0	20190628	經濟部技術處	工研院
21	62	P52080043CN	發明	審查中	中國大陸	容錯系統及其控制方法	CN202010078277.1	20200203	經濟部技術處	工研院
	63	P52080043TW	發明	獲證	中華民國	容錯系統及其控制方法	TW108144322	20191204	經濟部技術處	工研院
	64	P52080043US	發明	審查中	美國	容錯系統及其控制方法	US16941187	20200728	經濟部技術處	工研院

(四) 雲端 (1 案 4 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	專利中文名稱	申請案號	官方申請日	主辦單位	專利權人	契約運用
22	65	P52070038BE	發明	審查中	比利時	產生數值資料的安全替代表示碼的方法及計算機程式產品	EP19164301.4	20190321	經濟部技術處	工研院	



	66	P52070038DE	發明	審查中	德國	產生數值資料的安全替代表示碼的方法及計算機程式產品	EP19164301.4	20190321	經濟部技術處	工研院	
	67	P52070038DK	發明	審查中	丹麥	產生數值資料的安全替代表示碼的方法及計算機程式產品	EP19164301.4	20190321	經濟部技術處	工研院	
	68	P52070038NL	發明	審查中	荷蘭	產生數值資料的安全替代表示碼的方法及計算機程式產品	EP19164301.4	20190321	經濟部技術處	工研院	

(五) 人工智慧 (5 案 16 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	專利中文名稱	申請案號	官方申請日	委辦單位	專利權人	契約運用
23	69	P52070018CN	發明	審查中	中國大陸	深度神經網路硬體加速器與其操作方法	CN201910065762.2	20190123	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	70	P52070018TW	發明	獲證	中華民國	深度神經網路硬體加速器與其操作方法	TW107144665	20181212	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	71	P52070018US	發明	審查中	美國	深度神經網路硬體加速器與其操作方法	US16248042	20190115	經濟部技術處	工研院	非專授權中
24	72	P52070095CN	發明	審查中	中國大陸	使用卷積神經網路模型的對象檢測方法及對象檢測設備	CN201910298504.9	20190415	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	73	P52070095JP	發明	獲證	日本	使用卷積神經網路模型的物件偵測方法及物件偵測設備	JP2019028154	20190220	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	74	P52070095TW	發明	獲證	中華民國	使用卷積神經網路模型的物件偵測方法及物件偵測設備	TW108104861	20190213	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	75	P52070095US	發明	獲證	美國	使用卷積神經網路模型的物件偵測方法及物件偵測設備	US16215675	20181211	經濟部技術處	工研院	非專授權中
25	76	P52080029CN	發明	審查中	中國大陸	臉部影像重建方法與系統	CN202010106102.7	20200220	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	77	P52080029TW	發明	獲證	中華民國	臉部影像重建方法與系統	TW108139712	20191101	經濟部技術處	工研院	
	78	P52080029US	發明	獲證	美國	臉部影像重建方法與系統	US16715548	20191216	經濟部技術處	工研院	
26	79	P52080050CN	發明	審查中	中國大陸	卷積神經網路運算裝置及其運算的方法	CN202010160647.6	20200310	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	80	P52080050TW	發明	暫准	中華民國	卷積神經網路運算裝置及其運算的方法	TW109104865	20200215	經濟部技術處	工研院	非專授權中
	81	P52080050US	發明	審查中	美國	卷積神經網路運算裝置及其運算的方法	US16860381	20200428	經濟部技術處	工研院	非專授權中
27	82	P52080067CN	發明	審查中	中國大陸	基於硬體結構感知的自適應學習式功率建模方法與系統	CN202011159495.4	20201026	經濟部技術處	工研院	
	83	P52080067TW	發明	審查中	中華民國	基於硬體結構感知的自適應學習式功率建模方法與系統	TW109100589	20200108	經濟部技術處	工研院	
	84	P52080067US	發明	審查中	美國	基於硬體結構感知的自適應學習式功率建模方法與系統	US16728341	20191227	經濟部技術處	工研院	



(六) 雷射創新應用 (17 案 27 件)

案號	序號	申請案號	發明	獲證	國家	專利中文名稱	申請案號	獲證日期	發明人	專利權人	類別
28	85	P27000020CN	發明	獲證	CN	激光切割方法與裝置	201110328156.9	20111025	經濟部技術處	工研院	
	86	P27000020TW	發明	獲證	TW	雷射切割方法與裝置	100135907	20111004	經濟部技術處	工研院	
29	87	P27000034TW	發明	獲證	TW	均勻打光之掃描式視覺系統	100138619	20111025	經濟部技術處	工研院	
30	88	P27000035CN	發明	獲證	CN	激光加工誤差校正方法及處理器	201110444913.9	20111227	經濟部技術處	工研院	
	89	P27000035TW	發明	獲證	TW	雷射加工誤差校正方法及處理器	100146722	20111216	經濟部技術處	工研院	曾非專
31	90	P27010021TW	發明	獲證	TW	雙極板製造方法	101136582	20121003	經濟部技術處	工研院	曾非專
32	91	P27010042TW	發明	獲證	TW	雷射加工裝置及其方法	101147470	20121214	經濟部技術處	工研院	曾非專
33	92	P27010060TW	發明	獲證	TW	導電膜及其製法	101144422	20121128	經濟部技術處	工研院	
34	93	P27010061TW	發明	獲證	TW	雷射加工裝置及其方法	101151210	20121228	經濟部技術處	工研院	
35	94	P27010064CN	發明	獲證	CN	光束產生裝置	201310050579.8	20130207	經濟部技術處	工研院	
	95	P27010064TW	發明	獲證	TW	光束產生裝置	101147922	20121217	經濟部技術處	工研院	
	96	P27010064US	發明	獲證	US	光束產生裝置	13/794,812	20130312	經濟部技術處	工研院	
36	97	P27020022TW	發明	獲證	TW	導電線路的形成方法	102139480	20131031	經濟部技術處	工研院	
37	98	P27020030TW	發明	獲證	TW	多光點光路裝置	102140841	20131111	經濟部技術處	工研院	
38	99	P27020052TW	發明	獲證	TW	應用熱輻射影像的雷射加工系統與其方法	102143261	20131127	經濟部技術處	工研院	
	100	P27020052US	發明	獲證	US	應用熱輻射影像的雷射加工系統與其方法	14/143,829	20131230	經濟部技術處	工研院	
39	101	P27960065TW	發明	獲證	TW	一種雷射校正片及雷射校正系統	96145525	20071130	經濟部技術處	工研院	曾非專
40	102	P27990028CN	發明	獲證	CN	激光掃描裝置	201110322633.0	20111021	經濟部技術處	工研院	



	103	P27990028TWC1	發明	獲證	TW	雷射掃描裝置	100137979	20111019	經濟部 技術處	工研院	曾非專
	104	P27990028USC1	發明	獲證	US	雷射掃描裝置	13/305,887	20111129	經濟部 技術處	工研院	
41	105	P27990056CN	發明	獲證	CN	移除玻璃板材邊緣 缺陷之裝置及其方法	201010607453.2	20101227	經濟部 技術處	工研院	
	106	P27990056TW	發明	獲證	TW	移除玻璃板材邊緣 缺陷之裝置及其方法	99144580	20101217	經濟部 技術處	工研院	
42	107	P70050001TW	發明	獲證	TW	雷射加工裝置及雷 射加工排屑裝置	105129291	20160909	經濟部 技術處	工研院	
43	108	P27010086TW	發明	獲證	TW	視覺誤差校正方法	102116750	20130510	工研院	工研院	
	109	P27010086CN	發明	獲證	CN	視覺誤差校正方法	201310243187.3	20130618	工研院	工研院	
	110	P27010086US	發明	獲證	US	視覺誤差校正方法	14/228,274	20140328	工研院	工研院	
44	111	P70060001TW	發明	獲證	TW	點膠裝置及方法	106110422	20170328	經濟部 技術處	工研院	

(七) 軟性製造技術 (11 案 21 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	專利中文名稱	申請案號	官方申請日	委辦單位	專利報人	契約運用
45	112	P27000001TW	發明	獲證	TW	可撓式基材及可撓 式電子裝置	100117018	20110516	經濟部 技術處	工研院	
	113	P27000001US	發明	獲證	US	可撓式基材及可撓 式電子裝置	13/338,081	20111227	經濟部 技術處	工研院	
46	114	P27000007US	發明	獲證	US	蒸鍍裝置與有機薄 膜的形成方法	13/337,317	20111227	經濟部 技術處	工研院	
47	115	P27000059CN	發明	獲證	CN	吸附式傳輸裝置	201110443108.4	20111227	經濟部 技術處	工研院	
	116	P27000059TW	發明	獲證	TW	吸附式傳輸裝置	100144009	20111130	經濟部 技術處	工研院	
	117	P27000059US	發明	獲證	US	吸附式傳輸裝置	13/411,185	20120302	經濟部 技術處	工研院	
48	118	P27010002CN	發明	獲證	CN	非連續複合阻擋 層、其形成方法及 包含其之封裝結構	201210410391.5	20121024	經濟部 技術處	工研院	
	119	P27010002TW	發明	獲證	TW	非連續複合阻擋 層、其形成方法及 包含其之封裝結構	101130751	20120824	經濟部 技術處	工研院	
	120	P27010002US	發明	獲證	US	非連續複合阻擋 層、其形成方法及 包含其之封裝結構	13/728,544	20121227	經濟部 技術處	工研院	
49	121	P27960048CN	發明	獲證	CN	等離子體輔助有機 薄膜沉積裝置	200710302363.0	20071225	經濟部 技術處	工研院	



	122	P27960048TW	發明	獲證	TW	電漿輔助有機薄膜 沉積裝置	96144382	20071123	經濟部 技術處	工研院	
	123	P27960048US	發明	獲證	US	電漿輔助有機薄膜 沉積裝置	12/046,042	20080311	經濟部 技術處	工研院	
50	124	P27970081TW	發明	獲證	TW	化學氣相沉積裝置 與聚對二甲苯薄膜 的形成方法	97148841	20081215	經濟部 技術處	工研院	曾非專
51	125	P27970082TW	發明	獲證	TW	電漿激發模組	97150317	20081223	經濟部 技術處	工研院	曾非專
	126	P27970082US	發明	獲證	US	電漿激發模組	12/456,438	20090616	經濟部 技術處	工研院	
52	127	P27980084TW	發明	獲證	TW	聚對二甲苯薄膜的 形成方法	98143702	20091218	經濟部 技術處	工研院	
	128	P27980084US	發明	獲證	US	化學氣相沉積裝置 與聚對二甲苯薄膜 的形成方法	12/876,226	20100906	經濟部 技術處	工研院	
53	129	P27980086TW	發明	獲證	TW	電漿激發裝置	98143862	20091221	經濟部 技術處	工研院	
54	130	P27990057TW	發明	獲證	TW	軟性元件輸送導正 裝置與方法	99141116	20101126	經濟部 技術處	工研院	曾非專
55	131	P70080015TW	發明	獲證	TW	電致變色元件製造 方法	100143098	20111124	經濟部 技術處	工研院	曾非專
	132	P70080015US	發明	獲證	US	電致變色元件製造 方法	13/649,408	20121011	經濟部 技術處	工研院	曾非專

(八) 智慧光纖雷射源 (5 案 8 件)

案次	序號	件編號	性質	狀態	國家	專利中文名稱	申請案號	官方申請日	委辦單位	專利權人	契約運用
56	133	P27000022TW	發明	獲證	TW	超快雷射產生系統 及其方法	100144575	20111205	經濟部 技術處	工研院	
	134	P27000022US	發明	獲證	US	超快雷射產生系統 及其方法	13/372,841	20120214	經濟部 技術處	工研院	曾非專
57	135	P27010041CN	發明	獲證	CN	激光裝置及產生激 光的方法	201210570210.5	20121225	經濟部 技術處	工研院	
	136	P27010041TW	發明	獲證	TW	雷射裝置及產生雷 射光的方法	101141895	20121109	經濟部 技術處	工研院	
58	137	P27010054TW	發明	獲證	TW	三維加工裝置	101145190	20121130	經濟部 技術處	工研院	
59	138	P27010063US	發明	獲證	US	填充裝置及其加熱 裝置	13/945,413	20130718	經濟部 技術處	工研院	
60	139	P27990045TW	發明	獲證	TW	光纖雷射系統	99143381	20101210	經濟部 技術處	工研院	
	140	P27990045US	發明	獲證	US	光纖雷射系統	13/017,053	20110131	經濟部 技術處	工研院	



(九) 積層製造技術 (4 案 15 件)

案次	序號	申請號	性質	狀態	國家	專利中文名稱	申請案號	官方申請日	受理單位	專利權人	契約運用
61	141	P27000091TW	發明	獲證	TW	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	101102390	20120120	經濟部技術處	工研院	
	142	P27000091US	發明	獲證	US	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	13/460,259	20120430	經濟部技術處	工研院	曾非專
	143	P27000091USD1	發明	獲證	US	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	15/294,051	20161014	經濟部技術處	工研院	
62	144	P27020031DE	發明	獲證	DE	粉體成型方法及其裝置	EP13198195.3	20131218	經濟部技術處	工研院	
	145	P27020031FR	發明	獲證	FR	粉體成型方法及其裝置	EP13198195.3	20131218	經濟部技術處	工研院	
	146	P27020031GB	發明	獲證	GB	粉體成型方法及其裝置	EP13198195.3	20131218	經濟部技術處	工研院	
	147	P27020031TW	發明	獲證	TW	粉體成型方法及其裝置	102140774	20131108	經濟部技術處	工研院	
	148	P27020031US	發明	獲證	US	粉體成型方法及其裝置	14/136,555	20131220	經濟部技術處	工研院	曾非專
63	149	P27020045DE	發明	獲證	DE	調控積層製造之裝置及其方法	EP14187224.2	20141001	經濟部技術處	工研院	
	150	P27020045FR	發明	獲證	FR	調控積層製造之裝置及其方法	EP14187224.2	20141001	經濟部技術處	工研院	
	151	P27020045GB	發明	獲證	GB	調控積層製造之裝置及其方法	EP14187224.2	20141001	經濟部技術處	工研院	
	152	P27020045TW	發明	獲證	TW	調控積層製造之裝置及其方法	102147539	20131220	經濟部技術處	工研院	曾非專
	153	P27020045US	發明	獲證	US	調控積層製造之裝置及其方法	14/477,249	20140904	經濟部技術處	工研院	
	154	P27020045USD1	發明	獲證	US	調控積層製造之裝置及其方法	15/850,096	20171221	經濟部技術處	工研院	
64	155	P27040037TW	發明	獲證	TW	積層製造方法	105111352	20160412	經濟部技術處	工研院	